中芯国际集成电路制造有限公司

公司代码:688981 公司简称:中芯国际

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅年度报告"第四节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

三、本公司董事会及董事和高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟不进行利润分配,该议案尚需提交2025年股东周年大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

第二节 公司基本情况

一、公司简介

(一)公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	中芯国际	688981	不适用
港股	香港联交所主板	中芯国际	00981	不适用

(二)公司存托凭证简况

□适用 √不适用

(三)联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	郭光莉	温捷涵
联系地址	中国上海市浦东新区张江路18号	中国上海市浦东新区张江路18号
电话	021-20812800	021-20812800
电子信箱	ir@smics.com	ir@smics.com

二、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆集成电路制造业领导者,拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套,向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。

除集成电路晶圆代工外,集团亦致力于打造平台式的生态服务模式,为客户提供设计服务与IP支持、光掩模制造等一站式配套服务,并促进集成电路产业链的上下游协同,与产业链中各环节的合作伙伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案。

(二)主要经营模式

1. 盈利模式

公司主要从事基于多种技术节点和技术平台的集成电路晶圆代工业务,并提供设计服务与IP支持、光掩模制造等配套服务。

2. 研发模式

公司具备完整、高效的创新机制,完善的研发流程管理制度和专业的研发团队,推进应用平台的研发,进一步夯实技术基础,构建技术壁垒。公司的研发流程主要包括七个阶段,即项目选择、可行性评估、项目立项、技术开发、技术验证、产品验证和产品投产,每个阶段均有严格的审批流程,从而确保研发项目的成功转化。 3. 采购模式

公司主要向供应商采购集成电路晶圆代工及配套服务所需的物料、零备件、设备、软件及技术服务等。为提高生产效率、加强成本控制,公司建立了采购管理体系。公司拥有成熟的供应商管理体系与较为完善的供应链安全体系,建立了供应商准入机制、供应商考核与评价机制及供应商能力发展与提升机制,在与主要供应商保持长期合作关系的同时,兼顾新供应商的导入与培养,加强供应链的稳定与安全。

4. 生产模式

公司按市场需求规划产能,并按计划进行投产,具体如下:

(1) 小批量试产:客户按照公司提供的设计规则进行产品设计。设计完成后,公司根据客户的产品要求进行小批量试产。

(2) 风险量产:小批量试产后的样品经封装测试、功能验证等环节,如符合市场要求,则进入风险量产阶段。风险量产阶段主要包括产品良率提升、生产工艺能力提升、生产产能拓展等。

(3) 批量生产:风险量产阶段完成且上述各项交付指标达标后,进入批量生产阶段。在批量生产阶段,销售部门与客户确认采购订单量,生产计划部门根据客户订单需求安排生产、跟踪生产进度并向客户提供生产进度报告。

5. 营销及销售模式

公司采用多种营销方式,积极通过各种渠道拓展客户。在与客户建立合作关系后,公司与客户直接沟通并制定符合其需求的解决方案。

公司通过市场研究,主动联系并拜访目标客户,推介与客户匹配的工艺和服务,进而展开一系列的客户拓展活动。公司通过与设计服务公司、IP供应商、EDA厂商、封装测试厂商、行业协会及各集成电路产业促进中心合作,与客户建立合作关系。公司通过主办技术研讨会等活动或参与半导体行业各种专业会展、峰会、论坛进行推广活动并获取客户。部分客户通过公司网站、口碑传播等公开渠道联系公司寻求直接合作。公司销售团队与客户签订订单,并根据订单要求提供集成电路晶圆代工以及相关配套服务,制造完成的产品最终将被发货至客户或其指定的下游封装、测试厂商。

公司结合市场供需情况、上下游发展状况、公司主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段等因素,形成了目前的晶圆代工模式。报告期内,上述经营模式的关键因素未发生重大变化。

(三)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2024年,全球半导体产业整体显现复苏迹象,产业链回暖趋势基本确立。由于半导体产业所涉及的应用领域广泛,各细分市场在同一时期的发展情况存在一定的分化。其中,在全球的先导产业领域,对智能化和高速运算性能的卓越追求持续推动相关应用领域的头部企业快速成长,引导相关产业呈现爆发式增长,已然成为半导体整体市场规模增量的主要驱动力;受益于新一轮智能终端产品的功能升级和性能提升,市场温和催化智能手机、个人电脑、穿戴类设备、消费电子等产品的换机潮,终端需求已呈现缓慢增长态势;在汽车电子领域,伴随电动汽车市场竞争日益激烈,车用芯片的库存消化逐渐出现减缓,该领域的半导体需求进入周期性调整阶段。

从半导体需求和晶圆代工情况来看,产业链内参与不同细分市场的企业发展情况同样呈现一定的差异。其中,先导产业对逻辑运算类芯片的需求增长迅速,对芯片设计、晶圆代工和封装形式的技术要求极高,已形成了一定的产业壁垒;智能手机、个人电脑、穿戴类设备、消费电子等产品所涵盖的半导体种类范围广、数量多,尽管市场呈现一定的回暖趋势,但产业链的上下游企业依然面临激烈的竞争格局;另外,作为市场份额相对较小的汽车与工业领域,其对产品规格和可靠性的要求相对特殊,且相关芯片设计与晶圆代工的产业链较为集中,对整体半导体和晶圆代工行业的影响有限。

从地域发展情况看,为加强半导体供应链便利,近地产业链建设已成为全球各国各地区发展半导体产业的大趋势。从中国大陆的产业建设情况来看,现有集成电路产业在芯片设计、晶圆代工产能规模、工艺技术能力、封装技术等领域与实际市场需求仍不匹配。我国作为全球最大的半导体消费市场之一,现阶段的半导体需求仍一定程度地依赖进口,国内产业链的上下游企业与全球头部企业在技术与规模化程度上仍存在较大差距,面临诸多挑战。随着新一轮科技创新举措的推动,行业具备较大的成长空间。

从行业特点看,晶圆代工行业仍然是半导体产业链的核心环节,具备高度的技术密集、人才密集和资金密集的特点。晶圆代工的运营过程对生产环境、能源、原材料、设备和质量体系等有非常严格的管理和执行规范,其研发和制造过程涉及材料学、化学、半导体物理、光学、微电子、量子力学等诸多学科,立足专业的技术团队与强大的研发能力,以及对工艺进行整合集成的工程能力,行业的技术门槛极高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆集成电路制造业领导者,拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套。根据全球各纯晶圆代工企业最新公布的2024年销售额情况,中芯国际位居全球第二,在中国大陆企业中排名第一。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来,晶圆代工企业多以技术领先性、平台多样性、性能差异化作为吸引客户的核心优势。随着市场需求更趋多元化,企业在纵向追求更小的晶体管结构的同时,也更注重利用量产工艺节点的性能基础开展横向的衍生平台建设,以满足庞大的终端市场的差异化需求。

与此同时,各类新型封装,设计服务以及光掩模等技术持续突破,为晶圆代工技术迭代赋能。在新型封装技术领域,各类形式的系统性解决方案有效地突破了晶体管线宽极限并进一步提高了多芯片集成的融合度;在设计服务领域,DTCO(Design Technology Co-Optimization,设计工艺协同优化)对具体设计和工艺匹配做评估和调整,有效地降低了半导体工艺开发的成本和使用风险;光掩模作为集成电路制造产业链上的核心关键工具,其掩模工艺和介质材料不断进化,进一步提升设计图形光刻的工艺表现。

伴随全球行业格局的变化,晶圆代工企业在专注自身工艺技术与平台建设的同时,也愈加重视产业生态布局,其产能规模效应和在地化的产业链协同能力已成为客户衡量供应链稳定性和完整性的重要因素之一。

从未来发展趋势看,晶圆代工企业通过持续拓展产能规模、新工艺研发,加强产业链协同等方式不断强化资本、技术和行业生态壁垒,少数企业占据市场主导地位的业态将长期存在,行业头部效应将愈加明显。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减(%)	2022年末
总资产	353,415,296	338,463,197	4.4	305,103,691
归属于上市公司股东的净资产	148,190,613	142,475,834	4.0	133,371,921
	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
营业收入	57,795,570	45,250,425	27.7	49,516,084
归属于上市公司股东的净利润	3,698,665	4,822,814	-23.3	12,133,079
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,645,419	3,269,518	-19.1	10,133,988
经营活动产生的现金流量净额	22,658,629	23,047,761	-1.7	36,591,209
加权平均净资产收益率(%)	2.5	3.5	减少1.0个百分点	10.0
基本每股收益(元/股)	0.46	0.61	-24.6	1.53
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.61	-24.6	1.53
研发投入占营业收入的比例(%)	9.4	11.0	减少1.6个百分点	10.0

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	12,593,782	13,675,528	15,609,410	15,916,850
归属于上市公司股东的净利润	508,959	1,137,326	1,059,907	992,473
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	622,330	666,044	911,078	445,967
经营活动产生的现金流量净额	3,566,576	-320,251	9,017,855	10,394,449

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

(一)普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)(1)	263,374
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)(2)	248,801
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

附注:

(1) 截至本报告期末,注册股东户数263,374户中:A股251,964户,港股11,410户。

(2) 截至2025年2月28日,注册股东户数248,801户中:A股237,788户,港股11,013户。

(二)截至报告期末前十名股东持股情况表

1. 截至本报告期末,本公司于香港已发行5,987,790,837股,约占本公司总股本75.07%,于上交所科创板已发行1,988,359,129股,约占本公司总股本24.93%。

2. 本公司香港股东名册由HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)及其他登记股东组成,其中HKSCC NOMINEES LIMITED代非登记股东持有股份约占本公司港股股份99.8%,其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.2%。

3. 根据香港证券及期货条例,持有本公司5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需自行进行权益申报。根据股东权益申报情况,大唐香港持有港股1,116,852,595股及鑫芯香港持有港股617,214,804股。公司已将前述股东所持股份数目从HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份数目中剔除。

4. A股股东性质按照中国结算A股股东名册中的持有人类别填报。

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	14,887,764	4,241,825,322	53.18	-	无	-	未知
大唐控股(香港)投资有限公司	-	1,116,852,595	14.00	-	无	-	境外法人
鑫芯(香港)投资有限公司	-	617,214,804	7.74	-	无	-	境外法人
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	-	127,458,120	1.60	-	无	-	其他
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-93,762,559	114,589,555	1.44	-	无	-	其他
中国信息通信科技集团有限公司	-	72,470,855	0.91	-	无	-	国有法人
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	13,386,547	68,896,936	0.86	-	无	-	其他
香港中央结算有限公司	32,372,345	39,681,173	0.50	-	无	-	其他
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	13,309,286	37,356,723	0.47	-	无	-	其他
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	19,549,800	34,399,236	0.43	-	无	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.大唐香港为中国信科的全资子公司。 2.鑫芯香港为国家集成电路基金的全资子公司。 3.国家集成电路基金的董事张新、李国华、唐雪峰、杨高峰同时担任国家集成电路基金二期的董事;监事秦斌、卢伟同时担任国家集成电路基金二期的监事;董事范冰同时担任国家集成电路基金二期的监事。 4.华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路基金、国家集成电路基金二期进行管理。 5.国家集成电路基金和国家集成电路基金二期有部分相同股东。 6.HKSCC NOMINEES LIMITED是香港中央结算有限公司的全资子公司。除此之外,公司不知悉上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(三)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(四)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(五)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,本集团实现营业收入人民币57,795.6百万元,比上年同期增加27.7%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币3,698.7百万元,比上年同期减少23.3%。报告期内,本集团的经营活动所得现金净额为人民币22,658.6百万元,较上年同期减少1.7%;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币54,559.3百万元,较上年同期增加1.3%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2025-005

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 鉴于公司2025年仍将维持较大规模的资本支出,为保障公司正常生产经营和未来发展需要,公司2024年度不进行利润分配(包括不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配)。

● 本次利润分配方案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年股东周年大会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据《开曼群岛公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")和中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称"公司")现行《经修订及重述组织章程大纲及细则》《利润分配政策》等规定,经董事会决议,公司2024年度不进行利润分配(包括不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配)。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年股东周年大会审议。

(二)是否可能触及A股其他风险警示情形

公司不触及A股其他风险警示情形,具体说明如下:

单位:人民币千元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	-	-	-
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	3,698,665	4,822,814	12,133,079
母公司报表本年度末累计未分配利润	44,377,619		
最近三个会计年度累计现金分红总额	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额	-		
最近三个会计年度平均净利润	6,884,853		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	-		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	是		
现金分红比例(%)	-		
现金分红比例是否低于30%	是		
最近三个会计年度累计研发投入金额	15,391,699		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入	152,562,079		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	10.1		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2024年度拟不进行现金分红的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润369,866.5万元,拟不进行利润分配,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业及其特点、发展阶段、自身经营模式及资金需求

1、所处行业及其特点

公司所属晶圆代工行业为半导体产业链前端的关键行业,具备高度的技术密集、人才密集和资金密集的特点。晶圆代工的运营过程对生产环境、能源、原材料、设备和质量体系等有非常严格的管理和执行规范,其研发和制造过程涉及材料学、化学、半导体物理、光学、微电子、量子力学等诸多学科,立足专业的技术团队与强大的研发能力,以及对工艺进行整合集成的工程能力,行业的技术门槛极高。

2、公司发展阶段及经营模式

当前,公司正处于推进产能建设、不断提升市场占有率的重要发展阶段,公司通过专注本业增强公司自身的核心竞争力和长期价值,确保公司在激烈的市场和竞争、不断变化的外部环境下,保持领先地位,为客户及股东创造价值。

3、资金需求

公司预计2025年度公司仍将维持较大规模的资本支出,预计超过公司最近一期经审计净资产的30%,资金需求较高,公司需预留足够资金来满足产能扩充、发展公司核心业务,充分保障公司平稳运营、健康发展。

(二)公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司2024年度未分配利润将累计滚存至下一年度,拟用于产能扩充、发展公司核心业务,通过进一步提升产能规模和技术水平,增强行业竞争力,从而实现净资产的稳步增厚和公司价值的不断增长,最大限度维护股东利益。

(三)中小股东参与利润分配决策的便利条件

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制,中小股东可通过投资者热线及邮箱等多种方式来表达对利润分配的意见和诉求。

同时,公司将于2025年股东周年大会提交审议《2024年度利润分配方案》,并将采用现场与网络投票相结合的表决方式,为中小股东参与决策提供便利,充分保障了公司股东尤其是中小股东享有平等权益。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为进一步增强投资者回报水平,公司自2024年起制定了"提质增效重回报"行动方案,在经营管理、研发创新、公司治理及投资者关系等方面采取积极措施,以进一步提高公司质量,保障投资者权益,促进公司健康可持续发展。

三、公司履行的决策程序

公司2025年3月27日董事会书面决议通过了《2024年度利润分配方案》,并同意提交至公司2025年股东周年大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2025年股东周年大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2025年3月28日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2025-006

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司
关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人:中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的子公司(以下简称"子公司")。

● 本次担保金额及实际担保余额:公司预计2025年度为子公司以及子公司之间互相提供担保新增额度合计不超过人民币(或等值外币)7,000,000万元。截至2025年2月28日,公司及子公司已实际为合并报表范围内子公司提供的担保余额为人民币(或等值外币)2,045,739.41万元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 本事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会进行审议 。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称"公司")根据其业务发展规划,并结合子公司的实际需求,预计2025年度为子公司以及子公司之间互相提供担保新增额度合计不超过人民币(或等值外币)7,000,000万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例
1	中芯国际控股有限公司	6,000,000	100%
2	中芯集电投资(上海)有限公司	500,000	100%
3	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	250,000	100%
4	中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	50,000	100%
5	中芯国际集成电路制造(天津)有限公司	50,000	100%
6	中芯西青集成电路制造有限公司	50,000	100%
7	中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司	50,000	100%
8	芯电半导体(上海)有限公司	50,000	100%
	合计	7,000,000	

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得)的实际业务发展需求,在新增担保额度内调剂使用。

(二)本次担保事项履行的审议程序

公司2025年3月27日董事会书面决议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》及《对外担保管理制度》的相关要求,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。上述担保预计额度有效期为董事会审议通过之日起12个月。

二、被担保人基本情况

(一)中芯国际控股有限公司

1、成立日期: 2015年7月28日

2、注册资本:445,000万美元

3、注册地点:中国(上海)自由贸易试验区丹桂路1059号1幢

4、法定代表人:刘训峰

5、经营范围:在国家允许外商投资的领域依法进行投资;受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所提供企业提供下列服务:(1)协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;(2)在外汇管理系统部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;(3)为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;(4)协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新科技的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;承接其母公司和关联公司的服务外包业务;集成电路产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套业务;自有物业出租。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)中芯集电投资(上海)有限公司

1、成立日期:2003年9月30日

2、注册资本:46,580万美元

3、注册地点:中国(上海)自由贸易试验区张江路18号

4、法定代表人:刘训峰

5、经营范围:在国家允许外商投资的领域依法进行投资;集成电路相关电子产品的研发、生产(由分支机构经营);受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:(1)协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;(2)在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;(3)为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;(4)协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新科技的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;承接其母公司和关联公司的服务外包业务;集成电路产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(三)中芯国际集成电路制造(上海)有限公司

1、成立日期:2000年12月21日

2、注册资本:244,000万美元

3、注册地点:中国(上海)自由贸易试验区张江路18号

4、法定代表人:刘训峰

5、经营范围:半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片制造、针测及测试,与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装,销售自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(四)中芯国际集成电路制造(北京)有限公司

1、成立日期:2002年7月25日

2、注册资本:100,000万美元

3、注册地点:北京市北京经济技术开发区文昌大道18号

4、法定代表人:刘训峰

5、经营范围:半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片的制造、针测及测试、光掩膜制造;与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、测试封装;销售自产产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(五)中芯国际集成电路制造(天津)有限公司

1、成立日期:2003年11月3日

2、注册资本:129,000万美元

3、注册地点:天津市西青经济开发区兴华道19号

4、法定代表人:刘训峰

5、经营范围:半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片制造、针测及测试,与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装、销售自产产品、及以上相关服务;自有房屋租赁。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(六)中芯西青集成电路制造有限公司

1、成立日期:2022年8月24日

2、注册资本:500,000万美元

3、注册地点:天津市西青经济技术开发区赛达十一纬路18号

4、法定代表人:刘训峰

5、经营范围:一般项目:集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;电子专用材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(不含投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);计量技术服务;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(七)中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司

1、成立日期:2014年10月28日

2、注册资本:40,000万美元

3、注册地点:中国(上海)自由贸易试验区张江路18号3号楼6楼

4、法定代表人:王永

5、经营范围:集成电路的制造、技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让、销售自产产品,从事上述相关产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(八)芯电半导体(上海)有限公司

1、成立日期:2009年3月3日

2、注册资本:1,200万美元

3、注册地点:中国(上海)自由贸易试验区张江路18号2号楼1楼-1

4、法定代表人: 刘训峰

5、经营范围:半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片制造、针测及测试,与集成电路有关的开发、设计服务、光掩膜制造、测试封装、销售自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率,满足公司整体生产经营的实际需要,且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司,担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为:上述担保事项有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展,符合公司的整体发展需要。各担保对象生产经营情况稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2025年2月28日,公司及其控股子公司对外担保余额为2,045,739.41 万元(已经汇率折算),其中公司为控股子公司提供的担保余额为17,718.61万元(已经汇率折算)。上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为13.80%、0.12%,占公司最近一期经审计总资产的比例为5.79%、0.05%。

截至本公告披露日,公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司无逾期担保的情况,涉及诉讼的担保金额为0元。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2025年3月28日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2025-020

转债代码:113623 转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司关于"凤21转债"2024年度付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 可转债付息债权登记日:2025年4月7日

● 可转债除息日:2025年4月8日

● 可转债兑息日:2025年4月8日

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月8日公开发行的可转换公司债券(以下简称"凤21转债")将于2025年4月8日开始支付自2024年4月8日至2025年4月7日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

1、债券名称:新凤鸣集团股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称:凤21转债

3、债券代码:113623

4、证券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券

5、发行日期:2021年4月8日

6、上市日期:2021年5月7日

7、发行规模:250,000.00万元

8、发行数量:2,500.00万张

9、面值和发行价格:本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

10、债券期限:本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年,即自2021年4月8日至2027年4月7日。

11、债券利率:第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

12、还本付息的期限和方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率。

(2)付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

②付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

13、转股期限:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年4月14日,即募集资金划至公司账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止,即2021年10月14日至2027年4月7日止。

14、转股价格:初始转股价格为人民币16.60元/股,最新转股价格为人民币16.00元/股。

15、可转债信用评级:AA

16、信用评级机构:联合资信评估股份有限公司

17、担保事项:本次可转债不提供担保。

18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")

二、本次付息方案

按照《募集说明书》中约定,本次付息为公司可转债"凤21转债"第四年付息,计息期间为2024年4月8日至2025年4月7日。本计息年度票面利率为1.50%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1、可转债付息债权登记日:2025年4月7日。

2、可转债除息日:2025年4月8日。

3、可转债兑息日:2025年4月8日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2025年4月7日上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体"凤21转债"持有人。

五、付息办法

1、本公司已与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户,则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。

2、中登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司